

超配（维持）

半导体行业双周报（2024/08/05-2024/08/18）

中芯、华虹 24Q3 指引乐观

2024年8月18日

刘梦麟

SAC 执业证书编号：

S0340521070002

电话：0769-22110619

邮箱：

liumenglin@dgzq.com.cn

陈伟光

SAC 执业证书编号：

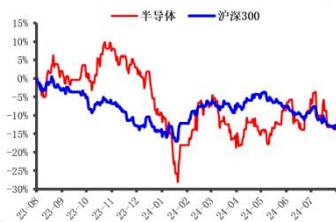
S0340520060001

电话：0769-22119430

邮箱：

chenweiguang@dgzq.com.cn

半导体行业（申万）指数走势



资料来源：东莞证券研究所，iFind

相关报告

投资要点：

- **半导体行业指数近两周涨跌幅：**截至2024年8月16日，半导体行业指数近两周（2024/8/5-2024/8/16）累计下跌5.49%，跑输沪深300指数4.35个百分点；8月以来累计下跌7.53%，跑输沪深300指数4.73个百分点；2024年以来累计下跌15.31%，跑输沪深300指数12.82个百分点。
- **半导体行业指数子板块近两周涨跌幅：**截至2024年8月16日，申万半导体板块各细分指数近两周全面下跌，跌幅从低到高依次为：SW数字芯片设计（-4.96%）>SW模拟芯片设计（-5.05%）>SW半导体材料（-5.37%）>SW半导体设备（-5.83%）>SW集成电路封测（-5.96%）>SW分立器件（-7.88%）。
- **近两周部分新闻和公司动态：**（1）鸿海第二季度净利润350亿元台币 同比增长6.1%；（2）鸿海预计第四季度销售额环比和同比均将增长；（3）Canalys：第二季度全球AI PC出货量占比达到14%；（4）TrendForce：预计2030年全球GaN功率元件市场规模上升至43.76亿美元 CAGR高达49%；（5）机构：2024年AI SSD采购容量预计突破45EB；（6）国家统计局：7月集成电路产量375亿块，同比增长26.9%；（7）机构：上修台湾地区半导体业全年总产值至1679亿美元，年增20.6%；（8）7月韩国存储芯片出口额达68亿美元，环比减少23%；（9）机构：预计NAND IC销售额将在2024年实现同比99%的增长；（10）中芯国际：第二季净利润1.646亿美元 同比下降59%；（11）中芯国际：预计2024年第三季度收入环比增长13%至15% 毛利率介于18%至20%范围内；（12）中芯国际：第二季月产能增至83.7万片8吋晶圆约当量 产能利用率升至85.2%；（13）新洁能：上半年净利润2.18亿元，同比增长47.45%；（14）海光信息：上半年净利润同比增长25.97%。
- **周报观点：**2024年8月，中芯国际、华虹半导体两家内资晶圆代工大厂均发布了24Q2财报，其中，中芯国际Q2营收、毛利率超出前期指引上限，且产能利用率从Q1的80.8%提升至85.2%，并预示Q3收入环比增长13%至15%，毛利率介于10%至20%范围内，环比实现大幅增长，表明下游需求持续复苏；华虹Q2营收符合指引，且毛利率超出前期指引上限，产能利用率接近满载，主要原因为下游需求全面复苏，尤其是AI相关需求持续强劲。

本报告的风险等级为中高风险。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。

请务必阅读末页声明。

进入2024年以来，伴随着下游需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式进入上行周期，且从Q2业绩预告情况看，半导体设备材料、存储、CIS等细分板块龙头企业24Q2业绩均实现同比、环比大幅增长，且受益消费类电子需求强劲，苹果、高通、联电等海外企业最新财季业绩高于预期，表明行业景气度延续。我们认为行业仍在相对底部区间，可关注Q2表现相对较好的半导体设备与材料、存储、CIS、封测等细分板块。

- **风险提示：**终端需求不及预期、国产替代不及预期、价格竞争加剧等。

目录

1. 半导体行业行情回顾	4
2. 半导体产业新闻	5
3. 公司公告与动态	7
4. 半导体产业数据更新	9
4.1 智能手机出货数据	9
4.2 新能源汽车销售数据	9
4.3 全球、国内半导体月度销售数据	10
4.4 全球、中国大陆半导体设备销售数据	10
5. 投资建议	10
6. 风险提示	14

插图目录

图 1: 半导体行业 2021 年初至今行情走势 (截至 2024 年 8 月 16 日)	4
图 2: 全球智能手机季度出货量 (2018/03-2024/06)	9
图 3: 国内智能手机月度出货情况 (2022/03-2024/06)	9
图 4: 新能源汽车销量及同比增长率 (2022/07-2024/07)	9
图 5: 国内新能源汽车销量及渗透率 (2022/07-2024/07)	9
图 6: 全球半导体月度销售情况	10
图 7: 中国半导体月度销售情况	10
图 8: 全球半导体设备销售额 (季度)	10
图 9: 中国大陆半导体设备销售额 (季度)	10

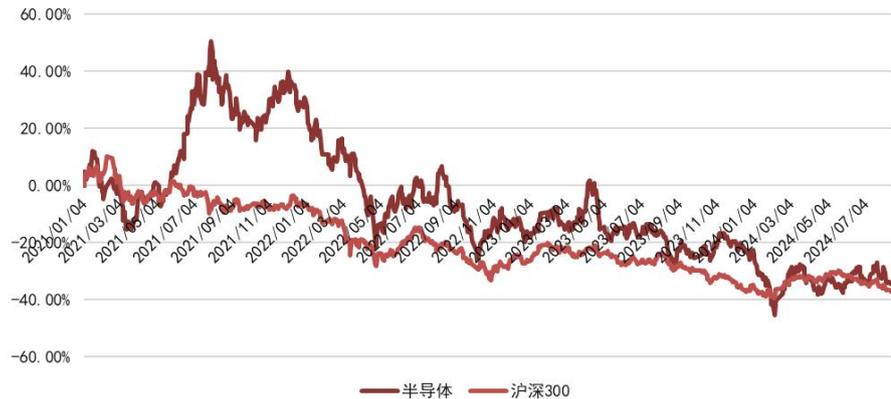
表格目录

表 1: 申万半导体行业各子板块涨跌幅情况 (单位: %) (截至 2024 年 8 月 16 日)	4
表 2: 申万电子所有三级子行业涨跌幅情况 (单位: %) (截至 2024 年 8 月 16 日)	4
表 3: 建议关注标的介绍 (2024/8/18)	11

1. 半导体行业行情回顾

半导体行业指数近两周涨跌幅：截至 2024 年 8 月 16 日，半导体行业指数近两周（2024/8/5-2024/8/16）累计下跌 5.49%，跑输沪深 300 指数 4.35 个百分点；8 月以来累计下跌 7.53%，跑输沪深 300 指数 4.73 个百分点；2024 年以来累计下跌 15.31%，跑输沪深 300 指数 12.82 个百分点。

图 1：半导体行业 2021 年初至今行情走势（截至 2024 年 8 月 16 日）



资料来源：iFind，东莞证券研究所

截至 2024 年 8 月 16 日，申万半导体板块各细分指数近两周全面下跌，跌幅从低到高依次为：SW 数字芯片设计（-4.96%）>SW 模拟芯片设计（-5.05%）>SW 半导体材料（-5.37%）>SW 半导体设备（-5.83%）>SW 集成电路封测（-5.96%）>SW 分立器件（-7.88%）。

表 1：申万半导体行业各子板块涨跌幅情况（单位：%）（截至 2024 年 8 月 16 日）

序号	代码	名称	近两周涨跌幅	本月至今涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	850812.SL	分立器件	-7.88	-8.86	-26.23
2	850813.SL	半导体材料	-5.37	-6.06	-19.47
3	850814.SL	数字芯片设计	-4.96	-7.87	-10.41
4	850815.SL	模拟芯片设计	-5.05	-7.61	-33.30
5	850817.SL	集成电路封测	-5.96	-9.13	-11.62
6	850818.SL	半导体设备	-5.83	-6.49	-2.39

资料来源：iFind，东莞证券研究所

表 2：申万电子所有三级子行业涨跌幅情况（单位：%）（截至 2024 年 8 月 16 日）

序号	代码	名称	近两周涨跌幅	本月至今涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	850813.SL	半导体材料	-5.37	-6.06	-19.47
2	850818.SL	半导体设备	-5.83	-6.49	-2.39
3	850814.SL	数字芯片设计	-4.96	-7.87	-10.41
4	850815.SL	模拟芯片设计	-5.05	-7.61	-33.30

5	850817.SL	集成电路封测	-5.96	-9.13	-11.62
6	850812.SL	分立器件	-7.88	-8.86	-26.23
7	850853.SL	品牌消费电子	-1.06	-4.97	-30.19
8	850854.SL	消费电子零部件及组装	-2.07	-5.49	-6.47
9	850861.SL	电子化学品III	-5.07	-7.90	-24.79
10	850831.SL	面板	-0.46	-2.54	-18.19
11	850832.SL	LED	-0.45	-1.69	-24.01
12	850833.SL	光学元件	-0.09	-3.22	-18.10
13	850822.SL	印制电路板	-3.32	-7.37	7.36
14	850823.SL	被动元件	-3.66	-6.89	-9.26
15	850841.SL	其他电子III	-3.15	-4.41	-18.12

资料来源：iFind、东莞证券研究所

2. 半导体产业新闻

1. 【鸿海第二季度净利润 350 亿元台币 同比增长 6.1%】

财联社 8 月 14 日电，鸿海第二季度净利润 350 亿元台币，同比增长 6.1%，预估 345 亿元台币；第二季度营收 1.55 万亿元台币，同比增长 19%，预估 1.52 万亿元台币。鸿海上半年净利润 570.5 亿元台币。

2. 财联社 8 月 14 日电，鸿海预计第四季度销售额环比和同比均将增长。

3. 财联社 8 月 14 日电，鸿海发言人表示，AI 伺服器业务今年每季将持续增长，并将超越公司预期。

4. 【Canalys：第二季度全球 AI PC 出货量占比达到 14%】

财联社 8 月 14 日电，Canalys 报告显示，2024 年第二季度，AI PC 的出货量为 880 万台。这些设备包括台式机和笔记本，配备专用 AI 工作负载的芯片组或模块，如 NPU。AI PC 出货量占本季度 PC 总出货量的 14%。目前，随着各大处理器供应商的 AI PC 规划逐步推进，预计 2024 年下半年及未来，AI PC 供应量和用户采用率将显著提升。Canalys 预测，AI PC 的市场表现基本符合预期，2024 年出货量将达到 4400 万台，2025 年有望达到 1.03 亿台。

5. 【消息称 SK 海力士正在扩产 DRAM】

《科创板日报》13 日讯，据业内人士透露，SK 海力士正在提高利川 M16 工厂的 DRAM 产能。公司已经向主要设备供应商订购核心设备，预计设备将从今年 Q4 开始供货，明年初开始增加产能。（Chosun Biz）

6. 【TrendForce：预计 2030 年全球 GaN 功率元件市场规模上升至 43.76 亿美元 CAGR 高达 49%】

《科创板日报》14 日讯，根据 TrendForce 集邦咨询最新报告显示，随着英飞凌、

德州仪器对 GaN 技术倾注更多资源，功率 GaN 产业的发展将再次提速。2023 年全球 GaN 功率元件市场规模约 2.71 亿美元，至 2030 年有望上升至 43.76 亿美元，CAGR（复合年增长率）高达 49%。其中非消费类应用比例预计会从 2023 年的 23% 上升至 2030 年的 48%，汽车、数据中心和电机驱动等场景为核心。

7. 【机构：2024 年 AI SSD 采购容量预计突破 45EB】

财联社 8 月 12 日电，市场调研机构 TrendForce 集邦咨询最新研报显示，由于 AI 需求大幅升温，最近两季 AI 服务器相关客户向供应商进一步要求加单 Enterprise SSD（企业级固态硬盘）。上游供应商为了满足 SSD 在 AI 应用上的供给，加速制程升级，开始规划推出 2YY 产品，预期于 2025 年量产。该机构预估，今年 AI 相关 SSD 采购容量将超过 45EB，未来几年，AI 服务器有望推动 SSD 需求年增率平均超过 60%，而 AI SSD 需求在整个 NAND Flash（闪存）的占比有机会自 2024 年的 5%，上升至 2025 年的 9%。

8. 【Canalys：预计 2028 年超大规模云市场销售额达 850 亿美元】

《科创板日报》16 日讯，根据 Canalys 最新报告，预计到 2028 年，通过超大规模云市场（由 AWS、Microsoft 和 Google Cloud 主导）销售的企业软件将达到 850 亿美元，高于 2023 年的 160 亿美元。通过超大规模市场进行第三方购买的云信用额度以及新的数字优先买家的出现正在重塑企业客户采购行为、供应商销售策略和渠道模式。虽然目前大多数供应商通过这些市场进行的销售都是“直接”面向最终客户，但渠道合作伙伴正在发挥越来越重要的作用。到 2027 年，Canalys 预计超过 50% 的市场销售额将通过渠道进行。

9. 【国家统计局：7 月集成电路产量 375 亿块，同比增长 26.9%】

据国家统计局最新数据显示，7 月计算机、通信和其他电子设备制造业增长 14.3%。其中，7 月微型计算机设备产量 2830 万台，同比增长 12.1%，环比减少 4.5%，累计 1-7 月产量 18552 万台，同比增长 2.7%。

7 月移动通信手持机产量 12830 万台，同比增长 6.5%，环比减少 3.4%，其中智能手机 9234 万台，同比增长 4.9%，环比减少 7.4%；累计 1-7 月移动通信手持机产量 87824 万台，同比增长 9%，智能手机产量 65381 万台，同比增长 10.6%。

7 月集成电路产量 375 亿块，同比增长 26.9%，环比增长 3.6%，半导体产业增长势头强劲；累计 1-7 月产量 2445 亿块，同比增长 29.3%。

10. 【机构：上修台湾地区半导体业全年总产值至 1679 亿美元，年增 20.6%】

据台媒报道，台湾地区半导体产业协会（TSIA）再次上修台湾地区半导体产值预估，将今年台湾地区半导体业总产值预估上修至 5 兆 2,369 亿元（新台币，下同，约合 1679 亿美元）、预计将创历史新高，产值年增率预估上修至 20.6%。

TSIA 今年 2 月曾预测台湾地区半导体产业产值将达到约 5.01 兆元，年增 15.4%，5 月上修预估至 5 兆 1,134 亿元，年增 17.7%。

根据最新预测,今年台湾地区 IC 设计业产值将达 1 兆 285 亿元(约合 412 亿美元)、年成长 17.2%; IC 制造业产值为 3 兆 3139 亿元(约合 1062 亿美元),年成长 24.5%,其中,晶圆代工为 3 兆 1099 亿元(约合 997 亿美元)、年成长 24.8%,存储与其他制造产值为 2040 亿元(约合 65 亿美元)、年成长 19.9%; IC 封装业为 4301 亿元(约合 138 亿美元),年成长 9.4%; IC 测试业产值为 2079 亿元(约合 67 亿美元)、年成长 9.1%。

11. 【7 月韩国存储芯片出口额达 68 亿美元,环比减少 23%】

据韩媒报道,韩国科技信息通信部最新 ICT 进出口统计数据显示,在半导体产业带动下,7 月韩国 ICT 出口达 194 亿美元,较去年同月增长 32.8%,连续第 9 个月实现增长。同期进口 121.2 亿美元,ICT 贸易顺差 72.8 亿美元。

从产品类别来看,7 月韩国半导体出口额达 112.3 亿美元,较去年同月增长 49%。其中,存储器半导体出口额达 68 亿美元,同比增长 89.0%,与 6 月的 88.3 亿美元相比,减少 22.9%。主要是由于存储芯片平均季度价格持续上涨以及对 HBM 等高附加值产品的需求扩大。

受电子设备市场复苏影响,显示器海外销售额小幅上涨 2%,达 19.3 亿美元;受中国和越南手机零部件需求大幅增加影响,手机出口额飙升 69.4%,达 12.3 亿美元。

由于数据中心需求不断增长,计算机及外围设备出口增长了 51.1%,达到 13.1 亿美元,但通信设备出口下降了 2.4%,至 1.9 亿美元。

12. 【机构:预计 NAND IC 销售额将在 2024 年实现同比 99%的增长】

《科创板日报》16 日讯, TechInsights 预计 AI 数据中心对数据存储解决方案的需求将增加。在 2024 年第二季度, AI 数据中心对大容量和高性能 NAND 内容的需求增加,推动了数据中心 SSD 市场的发展。今年剩余时间里,尽管一些消费领域复苏缓慢,但预计 NAND IC 销售额将在 2024 年实现同比 99%的增长,并在 2025 年实现同比两位数增长。

3. 公司公告与动态

1. 【中芯国际:第二季净利润 1.646 亿美元 同比下降 59%】

财联社 8 月 8 日电,中芯国际公告,第二季度营收 19.0 亿美元,环比增长 8.6%,同比增长 21.8%,市场预估 18.4 亿美元;第二季度净利润 1.646 亿美元,同比下降 59%,市场预估 7,630 万美元。中芯国际称,月产能由 2024 年第一季的 814,500 片 8 寸晶圆约当量增加至 2024 年第二季的 837,000 片 8 寸晶圆约当量。

2. 【中芯国际:预计 2024 年第三季度收入环比增长 13%至 15% 毛利率介于 18%至 20% 范围内】

财联社 8 月 8 日电, 中芯国际发布 2024 年第三季指引, 预期国际财务报告准则下的指引为: 预计 2024 年第三季度收入环比增长 13%至 15%, 毛利率介于 18%至 20% 的范围内。另据披露, 公司 2024 年第二季毛利率为 13.9%, 2024 年第一季为 13.7%, 2023 年第二季为 20.3%。

3. **【中芯国际: 第二季月产能增至 83.7 万片 8 吋晶圆约当量 产能利用率升至 85.2%】**

《科创板日报》8 日讯, 中芯国际月产能由 2024 年第一季的 814,500 片 8 吋晶圆约当量增加至 2024 年第二季的 837,000 片 8 吋晶圆约当量。产能利用率由 2024 年第一季的 80.8%升至 2024 年第二季的 85.2%。

4. **【德明利: 现有量产主控芯片已经覆盖移动存储产品各类型】**

财联社 8 月 13 日电, 德明利在互动平台表示, 公司目前已经完成了企业级 SSD 团队的组建, 并已有样品送样, 正在加快产品开发测试和客户送样工作。公司正在加快自研主控芯片的研发与量产, 现有量产主控芯片已经覆盖移动存储产品各类型, 为满足客户特定方案需求公司仍将有一定比例的外采主控。

5. **【华海诚科: 多年前已布局汽车电子行业 多款产品已实现批量销售】**

财联社 8 月 13 日电, 有投资者问华海诚科, 公司产品可以用于汽车芯片生产吗? 华海诚科在互动平台表示, 公司的常规产品和无硫 EMC 可以用于汽车电子的封装。公司多年前已布局汽车电子行业, 多款产品已实现批量销售。

6. **【联得装备: 汽车智能座舱领域 公司车载显示后壳组装等相关产品已形成销售收入】**

财联社 8 月 15 日电, 联得装备在互动平台表示, 在汽车智能座舱领域, 公司在双联屏/多联屏贴合设备、背光叠片设备、背光组装设备、点胶组装设备、车载显示后壳组装等相关产品上已形成销售收入。

7. **【捷捷微电: 上半年净利同比增 122.76%】**

财联社 8 月 15 日电, 捷捷微电披露半年报, 公司上半年实现营业收入 12.63 亿元, 同比增长 40.12%; 净利润 2.14 亿元, 同比增长 122.76%; 基本每股收益 0.29 元。

8. **【新洁能: 上半年净利润 2.18 亿元 同比增长 47.45%】**

财联社 8 月 12 日电, 新洁能发布 2024 年半年度报告摘要, 公司上半年实现营业收入 8.73 亿元, 同比增长 15.16%; 归属于上市公司股东的净利润 2.18 亿元, 同比增长 47.45%。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元 (含税)。

9. **【海光信息: 上半年净利润同比增长 25.97%】**

财联社 8 月 14 日电, 海光信息发布 2024 年半年度报告摘要, 公司实现营业收入 3,762,912,618.53 元, 同比增长 44.08%。归属于上市公司股东的净利润为 853,395,945.66 元, 同比增长 25.97%。

4. 半导体产业数据更新

4.1 智能手机出货数据

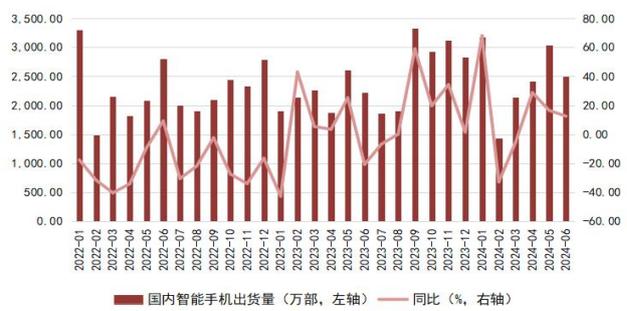
全球智能手机出货数据: 根据 IDC 数据, 2024 年第二季度全球智能手机出货量为 2.85 亿台, 同比增长 7.58%, 环比下降 1.38%; 2024 年上半年全球智能手机出货量为 5.75 亿台, 同比增长 7.66%。

国内智能手机出货数据: 根据工信部数据, 2024 年 6 月国内智能手机出货量为 2,384.10 万台, 同比增长 14.30%, 环比下降 16.64%。2024 年 1-6 月国内智能手机累计出货量为 1.46 亿台, 同比增长 13.17%。

图 2: 全球智能手机季度出货量 (2018/03-2024/06)



图 3: 国内智能手机月度出货情况 (2022/03-2024/06)



资料来源: IDC, 东莞证券研究所

资料来源: 工信部, 东莞证券研究所

4.2 新能源汽车销售数据

新能源汽车销售数据: 据工信部, 2024 年 7 月, 国内新能源汽车总销量为 99.1 万辆, 同比增长 27.0%, 环比下降 5.53%, 2024 年 7 月国内汽车总销量为 226.2 万台, 其中新能源汽车销量占比为 43.81%。

图 4: 新能源汽车销量及同比增长率 (2022/07-2024/07)



图 5: 国内新能源汽车销量及渗透率 (2022/07-2024/07)



资料来源: 中汽协, 东莞证券研究所

资料来源: 中汽协, 东莞证券研究所

4.3 全球、国内半导体月度销售数据

全球、中国半导体销售数据：根据美国半导体行业协会数据，2024 年 6 月全球半导体销售额 499.8 亿美元，同比增长 18.3%，环比增长 1.7%；国内半导体 2024 年 5 月销售额为 150.9 亿美元，同比增长 21.6%，环比增长 0.8%。

图 6：全球半导体月度销售情况



图 7：中国半导体月度销售情况



资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所

资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所

4.4 全球、中国大陆半导体设备销售数据

全国、中国大陆半导体设备销售额：根据 SEAJ 数据，2024 年第一季度全球半导体设备销售额为 264.2 亿美元，同比下降 2.00%，其中中国大陆半导体设备销售额为 125.2 亿美元，同比增长 113.00%。

图 8：全球半导体设备销售额（季度）



图 9：中国大陆半导体设备销售额（季度）



资料来源：SEAJ，东莞证券研究所

资料来源：SEAJ，东莞证券研究所

5. 投资建议

2024 年 8 月，中芯国际、华虹半导体两家内资晶圆代工大厂均发布了 24Q2 财报，其中，中芯国际 Q2 营收、毛利率超出前期指引上限，且产能利用率从 Q1 的 80.8% 提升至 85.2%，并预示 Q3 收入环比增长 13% 至 15%，毛利率介于 10% 至 20% 范围内，环比实现大幅增长，表明下游需求持续复苏；华虹 Q2 营收符合指引，且毛利率超出前期指引上限，产能利用率接近满载，主要原因为下游需求全面复苏，尤其是 AI 相关需求持续强劲。

进入 2024 年以来，伴随着下游需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式进

入上行周期，且从 Q2 业绩预告情况看，半导体设备材料、存储、CIS 等细分板块龙头企业 24Q2 业绩均实现同比、环比大幅增长，且受益消费类电子需求强劲，苹果、高通、联电等海外企业最新财季业绩高于预期，表明行业景气度延续。我们认为行业仍在相对底部区间，可关注 Q2 表现相对较好的半导体设备与材料、存储、CIS、封测等细分板块。

建议关注标的：

- **半导体设备与材料：**北方华创(002371)、中微公司(688012)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、鼎龙股份(300054)、江丰电子(300666)；
- **存储芯片：**兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、佰维存储(688525)；
- **模拟芯片：**圣邦股份(300661)；
- **先进封装：**长电科技(600584)、通富微电(002156)；
- **射频&CIS：**卓胜微(300782)、韦尔股份(603501)、思特威(688213)；
- **算力芯片：**海光信息(688041)

表 3：建议关注标的介绍（2024/8/18）

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
002371	北方华创	公司 2024 年一季度实现营收 58.59 亿元，同比增长 51.36%，实现归母净利润 1.27 亿元，同比增长 90.40%；公司预计 2024 年上半年实现营收 114.1 亿元至 131.4 亿元，同比增长 35.40%至 55.93%，预计 2024 年上半年实现归母净利润 25.70 亿元至 29.60 亿元，同比增长 42.84%—64.51%。报告期内，公司持续精研客户需求，丰富产品矩阵，不断提升核心竞争力。公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管和快速退火等工艺装备工艺覆盖度及市场占有率持续稳步攀升，收入同比稳健增长；此外，随着公司营收规模持续扩大，规模效应逐渐显现；智能制造助力运营水平有效提升；成本费用率稳定下降，使得归属于上市公司股东的净利润同比持续增长。
688012	中微公司	公司 2023 年实现营收 62.64 亿元，同比增长 32.15%，实现归母净利润 17.86 亿元，同比增长 52.67%；公司 2024 年第一季度实现营收 16.05 亿元，同比增长 31.23%，实现归母净利润 2.49 亿元，同比下降 9.53%。2024 年一季度，公司刻蚀设备持续获得国内外更多客户的认可，针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，其中刻蚀设备实现收入 13.35 亿元，较上年同期增长约 64.05%，刻蚀设备占营业收入的比重由上年同期的 66.55%提升至本期的 83.20%。费用支出方面，公司持续加大研发力度，积极推动多款新品研发，24Q1 研发投入同比增长约 62.43%，在业务扩张、人员增长背景下，公司销售费用和管理费用较上年同期分别增长 0.39 亿元和 0.18 亿元，拖累公司整体盈利表现。
688120	华海清科	公司 2024 年第一季度实现营收 6.80 亿元，同比增长 10.40%，实现归母净利润 2.02 亿元，同比增长 4.27%；公司预计 2024 年半年度实现营业收入为 145,000.00 万元至 152,000.00 万元，较上年同期相比增加 21,557.51 万元至 28,557.51 万元，同比增长 17.46%至 23.13%；公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 42,500.00 万元至 44,500.00 万元，较上年同期相比增加 5,090.27 万元至 7,090.27 万元，同比增长 13.61%至 18.95%。报告期内，公司持续加大研发投入和生产能力建设，企业核心竞争力持续提高，CMP 等专用装备、晶圆再生与耗材服务销售规模较同期均有不同程度

表 3: 建议关注标的介绍 (2024/8/18)

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
		增长。
688072	拓荆科技	公司 2023 年实现营收 27.05 亿元, 同比增长 58.60%, 实现归母净利润 6.63 亿元, 同比增长 79.80%; 公司 2024 年一季度实现营收 4.72 亿元, 同比增长 17.25%, 实现归母净利润 0.10 亿元, 同比下降 80.51%。公司 2024 年一季度归母净利润同比大幅下滑的主要原因为: 新产品验收周期较长导致季节性收入确认延后; 24Q1 保持研发投入同比增幅较大导致利润承压。公司为国内薄膜沉积设备龙头企业, 绑定本土客户有望受益行业国产化趋势, 布局混合键合, 打开企业成长空间。
300604	长川科技	公司 2024 年一季度实现营收 5.59 亿元, 同比增长 74.81%, 实现归母净利润 0.04 亿元, 同比增长 107.12%; 公司预计 2024 年上半年实现归母净利润 2.00 亿元至 2.30 亿元, 同比增长 876.62%至 1023.12%, 经营业绩拐点出现, 盈利能力明显改善。作为国内半导体测试设备平台型企业, 公司相比海外龙头企业规模偏小, 布局测试机、分选机、探针台和 AOI 等多个产品线, 成长空间持续打开。报告期内, 公司继续聚焦高端领域装备研发投入, 随着公司营收规模持续扩大, 规模效应逐渐显现; 同时, 公司运营管理水平有效提升, 费用率水平趋于稳定, 使得归属于上市公司股东的净利润有所增长。
300054	鼎龙股份	公司 2024 年第一季度实现营收 7.08 亿元, 同比增长 29.50%, 实现归母净利润 0.82 亿元, 同比增长 134.86%; 公司预计 2024 年上半年实现盈利 20,133.06 万元 - 22,050.50 万元, 同比增长 110% - 130%, 公司经营业绩同比大幅上升, 具体原因为: (1) 受国内半导体及 OLED 显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响, 公司光电半导体板块业务 (含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务) 实现营业收入约 6.4 亿元 (其中芯片业务收入已剔除内部抵消), 营收占比从 2023 年的 32% 持续提升至约 42% 水平; (2) 打印复印通用耗材业务保持稳步发展, 本期预计实现营业收入约 8.8 亿元, 同比略有增长。公司通过降本增效, 产品结构优化等多方面政策提升产品毛利率, 夯实公司在行业的竞争力; (3) 预计本报告期非经常性损益约为 2,000 万元, 主要是政府补助影响; 去年同期非经常性损益金额为 2,773.31 万元。
300666	江丰电子	公司 2024 年第一季度实现营收 7.72 亿元, 同比增长 36.65%, 实现归母净利润 0.60 亿元, 同比增长 7.16%; 公司预计 2024 年上半年实现归母净利润 15,298.88 万元 ~ 16,828.77 万元, 同比增长 0% 至 10%。报告期内, 公司持续加大研发投入, 提升新产品、新技术的研发能力, 强化先端制程产品竞争力, 努力扩大全球市场份额, 国内外客户订单持续增加, 营业收入持续增长。同时, 公司受益于在半导体精密零部件领域的战略布局, 多个生产基地陆续完成建设并投产, 迅速拓展产品线, 大量新产品完成技术攻关, 逐步从试制阶段推进到批量生产, 公司半导体精密零部件产品销售持续放量。
603986	兆易创新	公司 2024 年一季度实现营收 16.27 亿元, 同比增长 21.32%, 实现归母净利润 2.05 亿元, 同比增长 36.45%, 一季度归母净利润超过 2023 年总和。公司预计 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 51,800 万元左右, 与上年同期相比, 增加 18,202 万元左右, 同比增幅 54.18% 左右。经历 2023 年市场需求低迷和库存逐步去化后, 2024 年上半年消费、网通市场出现需求回暖, 带动公司存储芯片的产品销量和营收增长; 经营上, 公司继续保持以市占率为中心的策略, 持续进行研发投入和产品迭代, 不断优化产品成本, 公司多条产品线竞争力不断增强。2024 年上半年公司实现营业收入约 36.09 亿元, 同比增长 21.69%, 带动净利润增长约 54.18%。
688008	澜起科技	根据公司半年度业绩预告, 公司 2024 年半年度实现营业收入 16.65 亿元, 较上年同期增长 79.49%; 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 5.83 亿元 - 6.23 亿元, 较上年同期增长 612.73% - 661.59%。今年以来, 一方面, 公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长, DDR5 下游渗透率提升且 DDR5 子代迭代持续推进, 2024 年上半年公司 DDR5 第二子代 RCD 芯片出货量已超过第一子代 RCD 芯片; 另一方面, 公司部分 AI “运力” 芯片新产品开始规模出货, 为公司贡献新的业绩增长点, 以上两方面因素共同推动公司 2024 年上半年营业收入及净利润较上年同期大幅增长。
688525	佰维存储	根据公司半年度业绩预告, 预计深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年半年度实现营业收入 310,000 万元至 370,000 万元, 与上年同期相比, 将增加 195,171.25 万元至 255,171.25 万元, 同比增长 169.97%

表 3: 建议关注标的介绍 (2024/8/18)

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
		至 222.22%; 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 28,000 万元至 33,000 万元, 与上年同期相比, 将增加 57,647.54 万元至 62,647.54 万元, 同比增长 194.44%至 211.31%。本期业绩变化主要系行业复苏, 公司业务大幅增长。2024 年上半年公司紧紧把握行业上行机遇, 大力拓展国内外一线客户, 实现了市场与业务的成长突破, 产品销量同比大幅提升。公司在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入, 持续增强核心竞争力, 2024 年半年度研发费用约为 2.1 亿元, 同比增长超过 170%。
300661	圣邦股份	公司 2023 年实现营收 26.16 亿元, 同比下降 17.94%, 实现归母净利润 2.81 亿元, 同比下降 67.86%; 公司 2024 年一季度实现营收 7.29 亿元, 同比增长 42.03%, 实现归母净利润 0.54 亿元, 同比增长 80.04%。公司 2024 年第一季度经营业绩实现大幅增长, 且期间费用率有所下降, 降本增效成果显著。作为国内模拟芯片龙头企业, 公司产品性能和指标对标世界一流模拟厂商, 目前自主研发的可供销售产品 5,200 余款, 涵盖 32 个产品类别, 可满足客户的多元化需求, 有望受益于模拟芯片的国产替代进程。
300782	卓胜微	公司 2023 年实现营收 43.78 亿元, 同比增长 19.05%, 实现归母净利润 11.22 亿元, 同比增长 4.95%; 公司 2024 年一季度实现营收 11.90 亿元, 同比增长 67.16%, 实现归母净利润 1.98 亿元, 同比增长 69.83%。从 23Q3 开始, 消费电子市场需求迎来复苏, 公司受益华为旗舰强势回归, 23Q4、Q4 营收均实现同比增长; 2024 年第一季度, 公司 12 英寸 IPD 平台量产启动。自主 IPD 滤波器的 L-PAMiF 和 LFEM 模组已通过客户验证, 进入量产。同时, 自研 MAX-SAW 的 L-PAMiD 模组取得突破, 进入工程样品阶段。公司将集中资源, 持续优化产品性能与技术, 为未来客户推广奠定基础。
603501	韦尔股份	公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 130,779.21 万元到 140,779.21 万元, 同比增加 754.11%到 819.42%; 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 131,798.22 万元到 141,798.22 万元, 同比增加 1,769.15%到 1,895.79%。2024 年上半年, 市场需求持续复苏, 下游客户需求有所增长, 伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透, 公司的营业收入实现了明显增长; 此外, 为更好地应对产业波动的影响, 公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化, 公司的产品毛利率逐步恢复, 整体业绩显著提升。
688213	思特威	公司预计 2024 年半年度实现营业收入 240,000 万元到 250,000 万元。与上年同期相比, 将增加 132,729 万元到 142,729 万元, 增幅 124%到 133%; 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 13,500 万元到 15,500 万元。与上年同期相比, 将增加 20,134 万元到 22,134 万元。报告期内, 公司在智慧安防领域新推出的迭代产品在性能和竞争力上再度提升, 随着市场需求的回暖, 公司产品销量有较大的上升, 销售收入增加较为显著; 在智能手机领域, 公司应用于旗舰手机主摄、广角、长焦镜头的高阶 5000 万像素产品出货量大幅上升, 带动公司智能手机领域营收显著增长, 同时与合作全面加深, 市场占有率持续提升, 公司在智能手机领域已成功开辟出第二条增长曲线。故随着公司收入规模大幅增长, 盈利能力得到有效改善, 净利润率显著提升。
600584	长电科技	公司 2023 年实现营收 296.61 亿元, 同比下降 12.15%, 实现归母净利润 14.71 亿元, 同比下降 54.48%; 公司 2024 年一季度实现营收 68.42 亿元, 同比增长 16.75%, 实现归母净利润 1.35 亿元, 同比增长 23.01%。2023 年受到全球经济衰退的影响, 全球消费电子市场疲软, 全球半导体市场处于行业下行周期, 导致公司全年业绩承压, 但随着消费市场趋于稳定, 存储器市场回暖以及人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用, 公司 2023 年营收及净利润逐季环比抬升, 且 24Q1 实现同比双位数增长, 表明下游行业景气度正逐步回升。
002156	通富微电	公司预计 2024 年上半年实现归母净利润 2.88 亿元至 3.75 亿元, 同比增长 253.44%至 299.79%, 实现扣非后归母净利润 2.65 亿元至 3.55 亿元, 同比增长 201.37%至 235.80%。2024 年上半年半导体行业市场需求有所回暖, 在行业复苏的大背景下, 公司积极进取, 产能利用率提升, 营业收入增幅明显上升, 特别是中高端产品营业收入明显增加。经公司财务部门初步统计, 公司 2024 年第二季度的营业

表 3：建议关注标的介绍（2024/8/18）

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
		收入同比 2023 年第二季度、环比 2024 年第一季度，均明显增长。同时，得益于加强管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。
688041	海光信息	公司于 8 月 15 日披露半年报。公司 2024 年上半年实现营收 37.63 亿元，同比增长 44.08%，实现归母净利润 8.53 亿元，同比增长 25.97%。报告期内，营业收入同比实现较快增长，主要系市场需求增加，客户对公司产品的认可度进一步提升；同时公司持续提升产品性能，加大市场拓展力度，加强与客户及生态伙伴的合作深度与广度，促进了主营业务的较快增长。此外，公司持续加大研发投入力度，产品竞争力不断增强，研发投入同比增长 11.54%，营业收入增幅更大，使研发投入占营业收入比例有小幅下降。

资料来源：iFind，东莞证券研究所

6. 风险提示

(1) 终端需求不及预期：从 24Q1 看，半导体行业已进入上行周期，以智能手机为代表的终端需求回暖对板块业绩构成支撑。若后续下游需求不及预期，则可能对相关上市公司业绩造成不利影响；

(2) 国产替代不及预期：半导体设备与材料、高端元器件等领域的国产替代是大势所趋，若产业链公司技术突破不如预期导致国产替代进程受阻，则可能面临业绩增速放缓的风险；

(3) 价格竞争加剧：目前在集成电路、被动元器件等领域，国内上市企业以生产中低端产品为主，高端领域国产替代空间较大。若上市企业进行大量产能扩张，则行业未来可能面临产能过剩的局面，带来价格竞争导致盈利能力下滑的风险。

东莞证券研究报告评级体系:

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内, 股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内, 股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内, 股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内, 股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件, 或者其他原因, 导致无法给出明确的投资评级; 股票不在常规研究覆盖范围之内

行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明: 本评级体系的“市场指数”, A股参照标的为沪深 300 指数; 新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告, 市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板(含退市整理期)等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告, 港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系: “保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报, “谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报, “稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报, “积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报, “激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

证券分析师承诺:

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 以勤勉的职业态度, 独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点, 不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系, 没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益, 或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明:

东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司, 具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠, 但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告, 亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下, 本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用, 并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险, 据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有, 未经本公司事先书面许可, 任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发, 需注明本报告的机构来源、作者和发布日期, 并提示使用本报告的风险, 不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的, 应当承担相应的法律责任。

东莞证券股份有限公司研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码: 523000

电话: (0769) 22115843

网址: www.dgzq.com.cn